

特許協力条約

発信人 日本国特許庁（国際調査機関）

出願人 株式会社半導体エネルギー研究所	様
あて名 〒 243-0036 神奈川県厚木市長谷398番地	

PCT
国際調査機関の見解書
(法施行規則第40条の2)
[PCT規則43の2.1]

発送日
(日.月.年) 27. 4. 2004

出願人又は代理人 の書類記号 PCT6959	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/J P 2004/000899	国際出願日 (日.月.年) 30. 01. 2004	優先日 (日.月.年) 06. 02. 2003
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ¹ H01L21/3213, H01L21/28, H01L21/288, H01L21/336, H01L29/786, H01L21/3065, H05B33/14, B05D1/26, B05D3/04, B05D7/00, G02F1/1343, B25C5/00		
出願人 (氏名又は名称) 株式会社半導体エネルギー研究所		

1. この見解書は次の内容を含む。

- ☒ 第I欄 見解の基礎
- ☐ 第II欄 優先権
- ☐ 第III欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成
- ☐ 第IV欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第V欄 PCT規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第VI欄 ある種の引用文献
- ☐ 第VII欄 国際出願の不備
- ☐ 第VIII欄 国際出願に対する意見

2. 今後の手続き

国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。

この見解書が上記のように国際予備審査機関の見解書とみなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日から3月又は優先日から22月のうちいずれか遅く満了する期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当な場合は補正書とともに、答弁書を提出することができる。

さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照すること。

3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を参照すること。

見解書を作成した日 14. 04. 2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 長谷山 健 電話番号 03-3581-1101 内線 3462

様式PCT/ISA/237 (表紙) (2004年1月)

第 I 欄 見解の基礎

1. この見解書は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。

- ☐ この見解書は、_____ 語による翻訳文を基礎として作成した。
それは国際調査のために提出された PCT 規則 12.3 及び 23.1(b) にいう翻訳文の言語である。

2. この国際出願で開示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、以下に基づき見解書を作成した。

a. タイプ ☐ 配列表

☐ 配列表に関連するテーブル

b. フォーマット ☐ 書面

☐ コンピュータ読み取り可能な形式

c. 提出時期 ☐ 出願時の国際出願に含まれる

☐ この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された

☐ 出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された

3. ☐ さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

4. 補足意見：

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についてのPCT規則43の2.1(a)(i)に定める見解、
それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	1-5	有
	請求の範囲		無
進歩性 (IS)	請求の範囲		有
	請求の範囲	1-5	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-5	有
	請求の範囲		無

2. 文献及び説明

- 文献1: J P 2001-68827 A (大日本印刷株式会社)
2001.03.16, 全文, 第1-13図
- 文献2: J P 2002-324966 A (ハリマ化成株式会社)
2002.11.08, 全文
- 文献3: J P 11-340129 A (セイコーエプソン株式会社)
1999.12.10, 全文, 第1-8図
- 文献4: J P 2002-237480 A (積水化学工業株式会社)
2002.08.23, 全文, 第1-10図
- 文献5: J P 2002-237463 A (積水化学工業株式会社)
2002.08.23, 全文, 第1-11図
- 文献6: J P 2002-151478 A (積水化学工業株式会社)
2002.05.24, 全文, 第1-8図

請求の範囲1-5に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1-6により進歩性を有しない。

引用文献1により教示された複数の液滴噴射孔を有する液滴噴射ヘッドを備えた液滴噴射装置により局所的に導電膜を形成する技術、引用文献2により教示された金、銀、銅、白金、パラジウム、タングステン、ニッケル、タンタル、ビスマス等の金属微粒子を含有する導電性金属ペーストをインクジェット印刷法により基板上に分散させて配線パターンを形成する技術、引用文献3により教示されたレジストパターンを局所的に形成する技術、及び引用文献4-6により教示された大気圧近傍の圧力下でプラズマ発生手段により局所的にエッチング処理を施す技術を用いて局所的に配線を作製することは、当業者にとって容易である。

Partial Translation of Written Opinion (Application No.PCT/JP2004/000899)

Dated April 27,2004

2. Prior art document and Opinion

D1: JP 2001-68827 A (DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.)

2001. 03. 16, full text, Figures 1-13

D2: JP 2002-324966 A (HARIMA CHEMICALS, Inc.)

2002. 11. 08, full text

D3: JP 11-340129 A (SEIKO EPSON CORPORETION)

1999. 12. 10, full text, Figures 1-8

D4: JP 2002-237480 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.)

2002. 08. 23, full text, Figures 1-10

D5: JP 2002-237463 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.)

2002. 08. 23, full text, Figures 1-11

D6: JP 2002-151478 A (Sekisui Chemical Co., Ltd.)

2002. 05. 24, full text, Figures 1-8

Inventions of Claims 1 to 5 involve no inventive step over document D1 to D6 cited in the international search report.

It is easily for a person skilled in the art to form a wiring locally by using the technique in D1 that a conductive layer is formed locally using the droplet injection equipment including a droplet injection head having a plurality of droplet injection holes; the technique in D2 that a wiring pattern is formed by dispersing a paste of conductive metals including metal particles such as gold, silver, copper, platinum, palladium, tungsten, nickel, tantalum, bismuth, etc. on a substrate with ink jet printing method; the technique in D3 that a resist pattern is formed locally; and the technique in D4-6 that a local etching is performed by using a plasma generation device under the pressure comparable to atmospheric pressure.